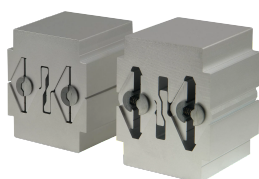


Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-ipcprocessors and AMD processors with the following sockets: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Compatible with Interscale C enclosures

Provides industry leading conduction cooling performance, 70% improvement over current conduction cooling methods

Conductor block expands/contracts vertically to compensate fortolerance stack up and optimizes surface contact and pressurealong the thermal path; eliminates the need for a thermal gappad

Secured to PCB with mounting brackets, sold separately

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Förpackningskvan titet	Djup	Bredd
---------------	-----	---------------	---------------------------	------	-------

24830-001	Värmeledare	Fall	1	50 mm	50 mm
-----------	-------------	------	---	-------	-------

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order the mounting bracket (Intel or AMD, listed under accessories) to assemble the FHC to the board.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE